

SV TCL & Associates Probe Company

LogicTouch™-Finepitch-vertikal

Die Schrumpfung der IC Die Geometrien und die zunehmende Komplexität der Geräte-Designs machen die Aufgabe des Tests auf Wafer zunehmend schwieriger. [SV TCLs LogicTouch™](#) für diese Arten von fortschrittlichen Designs eine fine-Pitch-Technologie nutzt eine MEMS-Stil-Sonde, die gezielt für Pad-begrenzte Geräte wie z. B. High-Volume-SoCs, Mikrocontroller, DSPs und 3D Pakete eignet sich perfekt. LogicTouch eignet sich auch für die [neuesten Geräteanwendungen](#) einschließlich TSV (durch-Silicon Via) und Kupfer-Säule (Cu-Säule).

- Fine-Pitch-Funktion bis 50µm
- Keine Chip-Design-Einschränkungen
- Probe-Arrays
- Ecke-Pads
- Einzelne Pin reparierbar
- MEMS-Stil Sonden
- Kohärenz der Scrub
- Mehr Dimensionskontrolle

Kontaktieren Sie Ihre [SV-TCL-Vertretung](#), damit wir Ihnen das richtige LogicTouch-Produkt für Ihre vertikalen Testanforderungen zu finden helfen können.